

# Willkommen bei O-Leading

Wir sind ein professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Produktpalette - einseitige, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir können einen schnellen Prototypenservice anbieten - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Arbeitsstunden Produktionszeit.

[Hochfrequenz PCB Großhandel China](#)

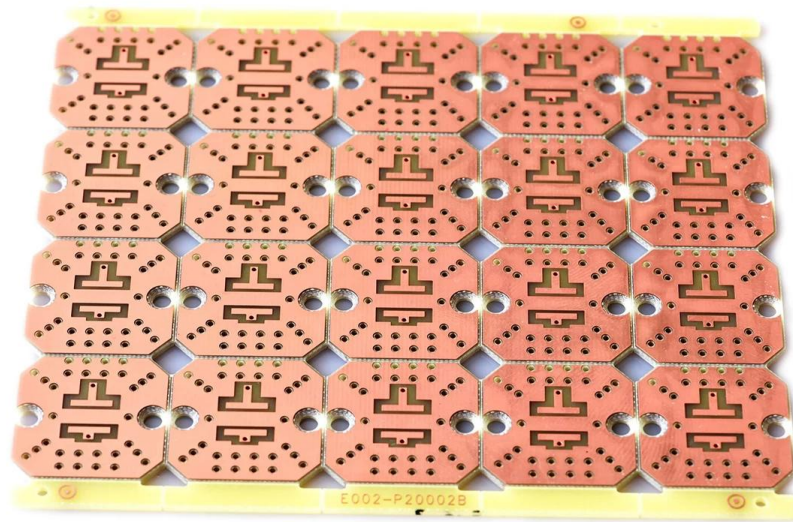
KUPFERPLATTENLÖCHER MINDESTENS .025 AVG, .020 MIN .. LÖCHER DÜRFEN NICHT STECKEN

Packen Sie mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 Stück / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke und legen Sie die Feuchtigkeitsanzeigekarte auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE AUF DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [PCB Layout Hersteller China](#)

## Produktbeschreibung

PCB P / N.	LE-500V1
Ebenenanzahl	1L
Material	Basiskeramik
Board thk	1,6 mm
Kupfer thk	1 Unze
Kleinste Lochgröße	2,0 mm
Anzahl der Löcher (Stcks)	16
Linie w /s	20/20 mil
Impedanzregelung. J / N (Tol%)	N.
Oberflächenveredelung	ENIG (Au: 0,05 um)
Lötmaske Siebdruck	Weiß schwarz
Einzelplatinengröße	Dim X (mm): Dim X (mm): 100; Dim Y (mm): 115
Panelisierung	Dim X (mm): 100; Dim Y (mm): 115; Anzahl der USV: 1
Besonderheit: abziehbare Maske	N.
Routing / Stanzen	CNC + Senkkopfschraube



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Mehrschichtplattenhersteller China](#)

Unser Team







Zertifizierungen



201726 21VQZL430354 - Wiring, Printed - Component

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354  
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [QPL Family of Databases](#).  
Click on a product designation for complete information.  
[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED 4190354  
Fortune Building, Nanheng West Road  
Room 1313  
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

Type	Cond Width		Cond	SS/ DS/	Area Diam	Solder Limits	Dper	Temp	Flame	RoHS	C
	Min	Max									
Min	Edge	Thk									
	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Hublayer (mass laminate) printed wiring boards.											
D-LEADING-401											
	0.2 (0.004)	0.5 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
D-LEADING-407											
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.2 (0.4)	260	10	170	V-0	NI	-
Hublayer printed wiring boards.											
D-LEADING-408											
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) mi-135	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	NI	-
Single layer printed wiring boards.											
D-LEADING-002											
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	NI	-
D-LEADING-003											
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	S5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
D-LEADING-033											
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	S5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	NI	-
D-LEADING-205											
	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-
D-LEADING-206											
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D6	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	NI	-

\* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.  
Last updated on 2017-01-27

Questions? [Print this page](#) [Terms of Use](#) [Page Top](#)



Test Report No. CANEC1805164701 Date: 03 Apr 2018 Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. Description  
SN1 CAN18-051647.001 Green PCB\*

Remarks:

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%  
(2) MDL = Method Detection Limit  
(3) ND = Not Detected (< MDL)  
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2014+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det?
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



Member of the SGS Group (SGS SA)



## Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM-Leiterplattenhersteller
Lieferdetail	7-12 Tage



## FAQ

1. Wie sichert O-Leading die Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit Folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach den Normen ISO 9001: 2008 kontrolliert.
2. Umfangreicher Einsatz von Software bei der Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Standortprüfgeräte und -werkzeuge. Z.B. Flugsonde, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. Engagiertes Qualitätssicherungsteam mit Fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Ausbildung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise für viele Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Der RMB in chinesischer Währung hatte gegenüber dem US-Dollar um 31% aufgewertet. Auch unsere Arbeitskosten sind deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies liegt ganz bei unseren Innovationen zur Kostensenkung, Vermeidung von Abfällen und Verbesserung der Effizienz. Unsere Preise sind in der Branche bei gleichem Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide

Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Vorteil in Bezug auf Kosten und Qualität bieten können.

3. Welche Arten von Boards kann O-Leading verarbeiten?

Gängige FR4-, High-TG- und Halogen-freie Platten, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupfer-basierte Platten, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenherstellung benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können auch Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → innerer Trockenfilm → inneres Ätzen → innerer AOI → Mehrfachbindung → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattenbeschichtung → äußerer Trockenfilm → Musterbeschichtung → äußeres Ätzen → äußerer AOI → Lötmaske → Komponentenmarkierung → Oberflächenbeschaffenheit → Arbeitsplan → E / T → Sichtprüfung.